

WAFER HANDLING SOLUTION

300mm アライナ 搭載

ウェハ エッジクランプ ハンド

特徴

- 300mmウェハのエッジのみクランプでアライメントします。
- 別置きアライナは必要ありませんのでコンパクトで安価なEFEMが構築できます。
- クランプと同時にアライメントしますので超高スループットです。
- アライメント時間は従来品の1/3です。
- ハンドに駆動モーター、ドライバー、制御基盤を搭載し、ロボットに即取付け可能です。
- 超コンパクト、超軽量設計です。



仕様	
非搬送物	SEMI・JEIDA規格300mmシリコンウェハ
ウェハ保持	エッジクランプ方式
位置決め時間	2.5秒以内
位置決め精度	センタリング ±0.3mm以内 ノッチ合わせ ±0.25°以内
駆動方法	5相ステッピングモータ、真空シリンダ
ユーティリティ	DC24V 3A 真空エア (-60~-80kPa) 20L/min以上
本体重量	0.8Kg

*This System has been
applied for an International patent.*

株式会社 **ダイナミックス**

〒024-0004 岩手県北上市村崎野19-291-1

TEL 0197-68-3531

FAX 0197-68-3532